



平成 22 年 7 月 22 日

各位

会社名 株式会社ブイ・テクノロジー

代表者名 代表取締役 杉本 重人

(コード番号 7717 東証マザーズ)

問合せ先 企画部 広報 I R 課長 河原 拓

(TEL 045-338-1980)

太陽電池製造装置（レーザースクライバ）受注のお知らせ

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 YBP イーストタワー 9F 社長：杉本重人）は、国内大手化学メーカーより有機太陽電池製造装置を受注しましたことをご知らせいたします。ブイ・テクノロジーはFPD（液晶パネル、PDPパネル）向け検査関連装置およびパネル製造装置に多くの実績を有しており、特にレーザー技術は競争優位性のある技術として自社で研究・開発し、当社製品へ応用しております。また、最近ではロールに巻いてある薄いガラスやフィルムに露光し、加工したガラスやフィルムを巻き取る（Roll to Roll）生産システムを設計・開発を進めております。

太陽電池製造関連のビジネス領域におきましては、これらの技術を活かし、フレキシブル性のある有機太陽電池の Roll to Roll の生産システムの受注活動を行っております。この度は、生産システムの核となるレーザースクライバを前述の顧客のテストラインで受注いたしました。太陽電池関連製造装置としては、今回が初受注であります。

業績への影響ですが、売上げは、今期中を予定しております。当案件の受注金額は、今期の業績見通しに対し、軽微（売上高の 10%以下、営業利益の 30%以下）です。また、今期の業績に既に織り込んでおりますので、今期の業績の見通しの変更はございません。今後、Roll to Roll 等の太陽電池生産システムを、ブイ・テクノロジーの第二の事業の柱として育てるべく、邁進してゆく所存です。2012 年 3 月期には当事業において、20 億円のビジネス規模を目指したいと考えております。

レーザースクライバは、太陽電池の基板上に成膜されている各薄膜層（透明電極膜（TCO膜）とアモルファスSi膜）を最適化されたレーザービームで切断するシステムです。

一般的にレーザースクライバは、1m前後の長さを切断するのに直径30-80um(1,000um=1mm)のレーザービームをおよそ30,000から60,000回重ね合わせながら行うため、加工時間がかかります。また、切断の線幅はレーザービームの直径と同じになります。線幅が細くなる程、太陽電池の発電効率が向上しますが、加工難易度が高くなります。

レーザースクライバ（製品名：Gemma（ジェンマ=宝石（かんむり座の恒星のひとつ）））は、ブイ・テクノロジーのFPD用修正装置、露光装置で培った特殊光学系を用いて独自の矩形レーザービーム形状(Long Rectangle Processing:LRP。長さ方向1,000um~60,000um 幅20~30um)でのレーザービーム加工を実現しました。レーザービームの形状を長さ60,000um(60mm)の矩形にすることにより、矩形レーザービームを、30から40回重ねて1m前後の長さを切断することができます。このことにより①作業時間の大幅な短縮による生産性向上、レーザービームの重ね合わせ箇所からの電流リークによる②歩留まり低下の可能性を大幅に抑制することに成功いたしました。また、より狭い線幅での加工により太陽電池の発電効率の向上が可能です。

ますます、高まる太陽電池産業の成長と顧客ニーズに応えるべく、
当社は「イノベーション、現場力、信頼性/安定性」を迫及した製品およびサービスを提供し続けてまいります。